

NEW
初級

半導体製造装置基礎(後編)

講師

半導体「後工程」を中心にグローバルリーダーが集結

一般社団法人 日本半導体製造装置協会(SEAJ)会員企業によるコラボレーション講座になります。

半導体デバイス製造に携わる装置・プロセスエンジニア向けに、装置開発・量産視点で市場環境・産業構造のレクチャー、求められる技術要素(メカ、エレクトロニクス、ソフト、プロセス)を概略説明。加えて装置・プロセス技術詳細を、各半導体製造装置メーカーより解説。高評価の半導体製造装置基礎(前編)に対し、本講座(後編)では半導体製造プロセス後工程の製造装置メーカーが結集します。(1章CMP装置概論は前工程、2章～5章が後工程になります)本講座は一般社団法人日本半導体製造装置協会(SEAJ)会員企業によるコラボレーション講座です。**前編を受講されていない方でも受講いただける内容となっております。**

1章

CMP装置概論

講師:荏原製作所



2章

パッケージング技術 概要+ボンダ概論

講師:ヤマハロボティクス
ホールディングス



3章

グラインダ・ダイシング マシン概論

講師:東京精密



4章

モールドイング装置 概論

講師:TOWA



5章

テスト概論

講師:アドバンテスト



2025年2月14日(金) 10:00~16:30

お申し込み締め切りは、2025年2月10日(月) 17:00までとなります。

受講料 初回限定
特別提供 2,200円(税込)

対面受講・オンライン受講 同時開催
定員 | 対面50名 / オンライン200名



●対面受講会場

福岡システムLSI総合開発センター
2F 講義室
住所 福岡市早良区百道浜3-8-33

●オンライン受講会場 Zoom

(接続先リンクはお支払い完了後にご案内)



●お申込み方法

ふくおかISTe-learningのホームページより、「講座・セミナー等 申込」をクリックし、「半導体製造装置基礎(後編)」の「対面受講申込」または「オンライン(OL)申込」を選択ください。

ふくおかISTe-learning

検索

本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。

e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団
福岡半導体リスティングセンター 事務局

- 対面受講、オンライン受講は同価格になります。 ■ お申込みには、「ふくおかISTe-learning」への会員登録が必要です。
- お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません。 ■ 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります。
- 講座当日、全受講者にpdfテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)配布、対面受講者には紙テキストも配布します。なおテキストの無断転載・複製等は禁止しています。
- オンライン受講は2画面(画面拡張モード:Zoom画面とpdfテキスト画面)を推奨します。
- 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止、又は延期する場合がございます。



福岡県内
中小企業の方は **受講料全額補助**

※消費税及び地方消費税を除く



詳細はこちら

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体
リスティングセンターのホーム
ページから、申請要領・交付
要綱をご確認ください。



公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団

福岡半導体リスティングセンター